



Communiqué de Presse

SY&SE remporte le Grand Prix des Exposants 2018

En cassant un dogme technologique, la jeune start-up de La Chaux-de-Fonds fait sensation avec une nouvelle technologie révolutionnaire d'assemblage de matériaux appelée à remplacer la colle ou autres soudures.

Genève, le 12 juin 2018 – Créé depuis 7 ans pour récompenser le projet le plus innovant de l'année présenté au Salon EPHJ-EPMT-SMT, le Grand Prix des Exposants a rassemblé pour cette édition un nombre très important de dossiers de candidature qui ont été transmis à un Jury d'experts composés d'Eric Rosset, Pierre Amstutz, André Colard, Olivier Saenger et Alexandre Catton.

Ce Jury a sélectionné 6 nominés : Axxios Technology SA, Optec Laser Systems, Vulkam, Cristaltech, Acquandas et SY&SE. Les projets de cette liste de 6 nominés ont ensuite été soumis au vote des exposants juste avant l'ouverture du Salon.

A l'issue de ce vote, c'est la société SY&SE, basée à La Chaux-de-Fonds (NE – Suisse), qui a recueilli le plus de suffrage et qui a donc reçu le Grand Prix des Exposants 2018 ce 12 juin, lors de la soirée d'ouverture du Salon EPHJ-EPMT-SMT. SY&SE est une start-up de la Haute Ecole Arc Ingénierie spécialisée dans l'assemblage des verres et céramiques aux métaux.

Cette jeune entreprise a mis au point une nouvelle technologie ICB (Impulse Current Bonding) dérivée de la liaison anodique qui permet de lier sans colle, et à basse température, des matériaux dont les coefficients de dilatation sont très différents. Cette technologie, au contraire de la colle ou des soudures à haute température, permet de préserver l'intégrité des matériaux et produit des assemblages d'une force et d'une étanchéité exceptionnelle.

Applicable à toutes les échelles de matériaux, cette technologie peut profiter à de nombreux secteurs industriels, notamment l'horlogerie et les medtech.

Contact SY&SE : M. Sébastien Brun, fondateur, s.brun@syandse.ch, Tel : +41 76 675 36 00

Contact média : M. Stephan Post, spo@dynamicsgroup.ch, Tel : +41 79 702 00 40